

出展のお知らせ

SEMICON[®] JAPAN 2024

このたび弊社は **SEMICON[®] JAPAN2024** に出展いたします。
会場では実機を展示し弊社の各種装置をご紹介します。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

枚葉式ウェット処理装置 TWPシリーズ
有機膜剥離・リフトオフ等、
高度な剥離プロセスを物理アシスト付ノズルで実現
展示会ではセミオート機『TWPsa』を実機展示



超音波カッティング装置（量産用途）CSX501
SiCウエハダイシング・セラミックス基板切断等、
高速・高品質カッティングを超音波アシストで実現
フルオート機『CSX501』実機展示



断面観察用 超音波カッティング装置 CSX-100Lab
不良箇所の解析・工程内の品質管理等、
断面試料の作製を超音波アシストで実現
『CSX-100Lab』実機展示



株式会社 高田工業所
装置事業部

✉ souchi_info@takada.co.jp

☎ 093-632-2600

🌐 <https://www.takada.co.jp/business/eeb/>

会場では、弊社開発の電流情報量診断システムをご紹介します。

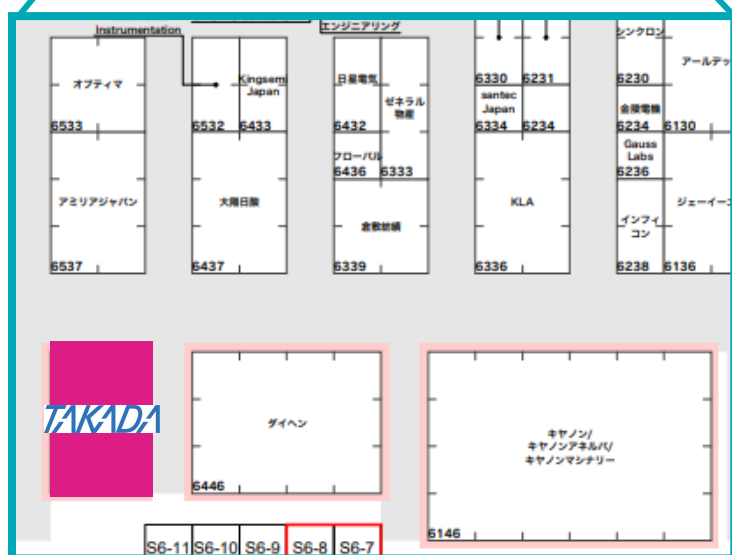


当社出展ブース

東京ビッグサイト

東6ホール 6547

フロアマップ 東4~6ホール



当社ブース(小間番号:6547)



ブース外観

株式会社 高田工業所

装置事業部

☎ souchi_info@takada.co.jp

☎ 093-632-2600



▲ website